

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XC61CxxxxxMR-G  
標準質量: 14 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.246	シリコン	17600	7440-21-3
リードフレーム	3.553	銅	253800	7440-50-8
	0.011	錫	800	7440-31-5
	0.006	亜鉛	400	7440-66-6
	0.011	クロム	800	7440-47-3
	0.159	銀	11300	7440-22-4
ダイアタッチ	0.040	銀	2900	7440-22-4
	0.007	エポキシ	500	—
ボンディングワイヤ	0.030	金	2100	7440-57-5
封止樹脂	7.916	溶融シリカ	565400	60676-86-0
	0.740	エポキシ樹脂	52800	—
	0.633	フェノール樹脂	45200	—
	0.450	金属水酸化物	32100	—
端子メッキ	0.200	錫	14300	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。